**同惠电子与东南大学签署先进功率芯片联合研发中心合作协议**

来源：仪商网

3月21日，同惠电子发布公告称，公司与东南大学于 2023 年 3月 20 日签署了合作协议，双方将共建先进功率芯片测试技术联合研发中心。

根据协议，双方将共建“东南大学—同惠电子先进功率芯片测试技术联合研发中心”，在功率芯片测试领域进行深层次合作，开发世界级水平、具有自主知识产权的、符合市场与应用需求的先进功率半导体芯片测试技术及设备，包括硅基功率器件测试技术、宽禁带功率器件测试技术、功率半导体集成电路测试技术等。

协议有效期为3年（2023年-2025年），同惠电子将分3年向东南大学提供经费1000万元：其中2023年支付500万元、 2024年支付200万元、2025年 支付300万元，如当年项目完成超出预期，同惠电子可以提前拨付后续费用或追加经费。

自成立以来，同惠电子始终专注于电子测量仪器的技术研发与产品开发，尤其在精密阻抗测量领域具有二十多年测试理论、测试技术和实践经验的积累。公司主要产品为各类电子测量仪器，用于各种电子元器件、材料、电子零部件、电子整机等被测对象的性能测试、测量、试验验证及品质保证。